

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 10065339 A

(43) Date of publication of application: 06 . 03 . 98

(51) Int. Cl

H05K 3/46

H05K 3/40

(21) Application number: 08221437

(71) Applicant: SONY CORP

(22) Date of filing: 22 . 08 . 96

(72) Inventor: MATSUDA YOSHINARI

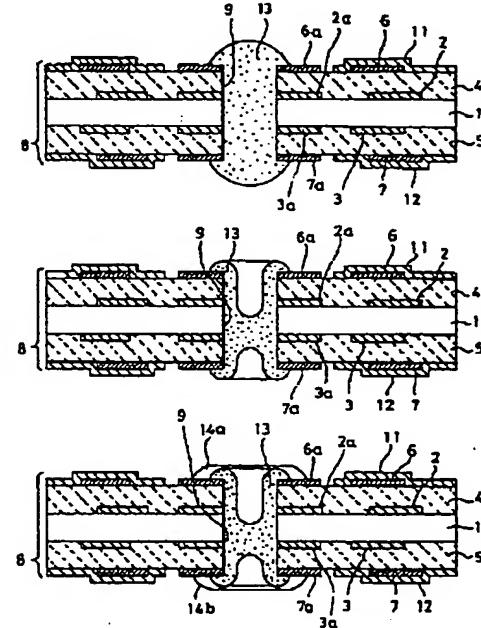
(54) MULTILAYER PRINTED WIRING BOARD AND
METHOD MANUFACTURING THEREFOR

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a multilayer printed wiring board of high reliability which enables improvement in productivity by a simple facility and cost cutting.

SOLUTION: A via hole 9 is formed through outer-layer land portions 6a, 7a of laminated outer-layer conductor circuits and inner-layer land portions 2a, 3a of laminated inner-layer conductor circuit on a multilayer printed wiring board with a plurality of conductor layers stacked via the insulating layers. And the via holes 9 is filled with conductive paste 13, heat curing of the conductive paste 13 is then performed to connect electrically the outer-layer land portions 6a, 7a and the inner-layer land portions 2a, 3a.

COPYRIGHT: (C)1998,JPO



(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-65339

(43)公開日 平成10年(1998)3月6日

(51)Int.Cl.*

H 05 K 3/46
3/40

識別記号

序内整理番号

7128-4E

F I

H 05 K 3/46
3/40

技術表示箇所

N
K

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

特願平8-221437

(22)出願日

平成8年(1996)8月22日

(71)出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 松田 良成

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

ー株式会社内

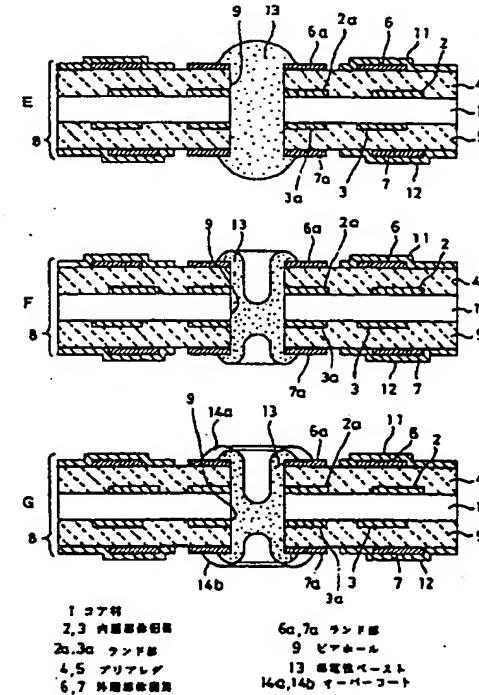
(74)代理人 弁理士 松隈 秀盛

(54)【発明の名称】 多層プリント配線板及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 簡単な設備で生産性を向上し、かつ低コスト化を図ることができると共に信頼性の高い多層プリント配線板を得る。

【解決手段】 絶縁層を介して複数の導体層が積層された多層プリント配線板において、積層された外層導体回路の外層ランド部6a, 7a及び内層導体回路の内層ランド部2a, 3aに貫通するピアホール9を形成し、このピアホール9に導電性ベースト13を孔埋め印刷し、導電性ベースト13を熱硬化することで外層ランド部6a, 7a及び内層ランド部2a, 3a間を電気的に導電接続するようにした。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 絶縁層を介して3層以上の導体層が積層された多層プリント配線板において、積層された各導体層部分に貫通するピアホールを形成し、ピアホールに導電性ペーストを孔埋め印刷し、導電性ペーストを熱硬化することで上記導体層の外層導体及び内層導体間を電気的に導電接続するようにしたことを特徴とする多層プリント配線板。

【請求項2】 請求項1記載の多層プリント配線板において、

上記導電性ペーストは上記外層導体では外層表面及び上記ピアホール孔面に露出する端面が導電接続され、上記内層導体では上記ピアホール孔面に露出する端面が導電接続されることを特徴とする多層プリント配線板。

【請求項3】 絶縁層を介して3層以上の導体層が積層された多層プリント配線板の製造方法において、

絶縁性のコア材の両表面にパターン化された導体層を形成し、このコア材の両面にそれぞれプリフレグを介して外層導体を加熱プレスして積層板を形成する工程と、

積層された各導体層部分に対応する位置で上記積層板に貫通するピアホールを形成する工程と、

上記外層導体をパターン化し、上記ピアホール周りの外層導体部分のランド部をマスキングして上記パターン化された外層導体上にソルダーレジストを形成する工程と、

上記ピアホールに導電性ペーストを孔埋め印刷すると共に、導電性ペーストを上記ランド部にまで印刷する工程と、

上記導電性ペーストを熱硬化する工程と、

上記ランド部上に露出する導電性ペースト面を絶縁性樹脂で印刷し保護する工程と、からなることを特徴とする多層プリント配線板の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、多層積層板の外層導体と内層導体とをピアホール（層渡りの孔）に形成した導電体によって電気的に接続するようにした多層プリント配線板とその製造方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】従来、この種ピアホールを有する4層の多層プリント配線板を図4に示す。符号41が例えばガラス-エポキシ樹脂系からなるコア材であり、このコア材41の上下面にパターン化された銅箔からなる内層導体42、43が形成されている。コア材41にはプリフレグ44、45を介してパターン化された同じく銅箔からなる外層導体46、47が積層されて積層板48が構成されている。

【0003】この内層導体42、43と外層導体46、47との対応する位置において積層板48にドリルにて貫通されたピアホール49が形成されている。そして、

このピアホール49及び外層導体46、47の孔周りであるランド部46a、47a以外をマスキングしてメッキ厚が3μm以下の無電解銅メッキ層50を形成し、続いて無電解銅メッキ層50の上からメッキ厚が15μm以上の電解銅メッキ層51を形成することによって外層導体46、47の一部であるランド部46a、47aとピアホール49の孔壁に露出する内層導体42、43とを電気的に接続している。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】ところで、ピアホール49に無電解銅メッキ層50及び電解銅メッキ層51を形成してランド部46a、47aと内層導体42、43とを電気的に接続する方法では、メッキ層の形成の都度に洗浄する工程が必要であり、このための水処理設備も大がかりなものとなり、従って、生産性及びコストの点で多くの問題がある。

【0005】本発明は、上述したような課題を解消するためになされたもので、簡単な設備で生産性を向上し、かつ低コスト化を図ることができると共に信頼性の高い多層プリント配線板及び多層プリント配線板の製造方法を得ることを目的とする。

【0006】

【課題を解決するための手段】上述の目的を達成するため、本発明による多層プリント配線板は、絶縁層を介して3層以上の導体層が積層された多層プリント配線板において、積層された各導体層部分に貫通するピアホールを形成し、ピアホールに導電性ペーストを孔埋め印刷し、導電性ペーストを熱硬化することで導体層の外層導体及び内層導体間を電気的に導電接続するようにしたるものである。

【0007】このように構成したこと、積層板に貫通させたピアホールに導電性ペーストを孔埋め印刷することによって外層導体と内層導体との導電接続を容易に行うことができる。

【0008】また、導電性ペーストは外層導体では外層表面及びピアホール孔面に露出する端面が導電接続され、内層導体ではピアホール孔面に露出する端面が導電接続されるようにした。導電性ペーストは熱硬化前ではゲル状（液状インク）であるため孔埋め印刷の際、外層導体面への密着はもとより導体端面に確実に密着し、導電性ペーストの熱硬化によって強固に固着させることができる。

【0009】また、本発明による多層プリント配線板の製造方法は、絶縁層を介して3層以上の導体層が積層された多層プリント配線板の製造方法において、絶縁性のコア材の両表面にパターン化された導体層を形成し、このコア材の両面にそれぞれプリフレグを介して外層導体を加熱プレスして積層板を形成する工程と、積層された各導体層部分に対応する位置で上記積層板に貫通するピアホールを形成する工程と、外層導体をパターン化し、

ピアホール周りの外層導体部分のランド部をマスキングしてパターン化された外層導体上にソルダーレジストを形成する工程と、ピアホールに導電性ベーストを孔埋め印刷すると共に、導電性ベーストをランド部にまで印刷する工程と、導電性ベーストを熱硬化する工程と、ランド部上に露出する導電性ベースト面を絶縁性樹脂で印刷し保護する工程と、からなる。

【0010】上述した製造方法により、積層板に貫通させたピアホールに導電性ベーストを孔埋め印刷を行う工程によって製作することができる。従って、従来のようにメッキ後に洗浄するような工程も一切不要となり、生産性を大幅に向上することができる。

【0011】

【発明の実施の形態】以下、本発明による多層プリント配線板及びその製造方法の実施例を図面を参照して説明する。

【0012】図1及び図2に4層構造の多層プリント配線板の製造工程を示す。図1Aは製造工程の初期の段階であり、絶縁性のコア材1の両面には銅箔が回路パターン化されて形成され、上面側を銅箔回路パターン2とし、下面側を銅箔回路パターン3とし、これら銅箔回路パターン2、3は内層導体回路となる。このうち符号2a、3aは銅箔回路パターン2、3の内層ランド部となる。尚、コア材1としてはエポキシ樹脂が含浸されたガラス布(一例としてFR-4、CEM-3)からなり、銅箔回路パターン2、3は厚みが12~70μmである。

【0013】このコア材1に対してガラス繊維をエポキシ樹脂で含浸させた絶縁性のプリプレグ4、5とパターン化されてない厚みが12~35μmの外層銅箔6、7を用意する。

【0014】そして、上述したコア材1とプリプレグ4、5及び外層銅箔6、7を重ね合わせ加熱状態でプレスすることで、図1Bに示すように板厚が0.8~1.6mmの積層板8を形成する。

【0015】次に、図1Cに示すように積層板8に貫通するピアホール9を形成する。このピアホール9は内層導体回路の内層ランド部2a、3aの中央を貫通するスルーホールであり、NCドリルにより穿孔される。尚、ピアホール9の穿孔の際、摩擦熱によりプリプレグの一部がピアホール孔面側に溶融し、いわゆるスミア10の発生により例えば内層ランド部3aの端面を覆うことがあるため、ピアホール9の孔面を過マンガン酸カリにより洗浄しスミア10を除去し清浄化する。

【0016】次に、図1Dに示すように外層銅箔6、7をエッティング処理により外層導体回路にパターン化し、このうち符号6a、7aは外層ランド部となる。続いて外層ランド部6a、7aをマスキングして外層導体回路上にソルダーレジスト11、12を写真食刻法またはスクリーン印刷法により形成する。尚、ここで、外層ラン

ド部6a、7a及び内層ランド部2a、3aは、例えば積層プリント配線板の導体回路の共通の電位となる部分である。

【0017】かくして、次の工程として図2Eに示すようにピアホール9内に導電性ベースト13をシルクスクリーン印刷法により孔埋め印刷する。この際、導電性ベースト13はピアホール9内に充填されると共に、外層ランド部6a、7a面に導電性ベースト13が盛り上がり付着するように印刷される。

【0018】導電性ベースト13の材料としては、フェノール樹脂、キシレン樹脂、メラミン樹脂または各種エポキシ樹脂と硬化剤との組み合わせからなる熱硬化樹脂のバインダー樹脂と希釈溶剤とを5~15重量%含有し、その他を導電性金属粉とした液状インクである。

【0019】また、導電性金属粉としては最大外径が50μm以下程度の銀粉、銅粉、ニッケル粉、銀メッキ銅粉、金メッキ銅粉または金メッキニッケル粉等が実用的である。具体例としては、銅粉ベーストの場合はタツタ電線(株)の商品名「DDベースト」、銀粉ベーストの場合はアサヒ化学研究所(株)の商品名「LS056、銀メッキ銅粉ベースト」の場合は旭化成(株)の商品名「AMG」が適している。

【0020】次に、積層板8を160°Cの熱風乾燥炉内に1時間投入して導電性ベースト13を熱硬化処理する。熱処理された導電性ベースト13は図2Fに示すように中央部表面が陥没状態となって体積が収縮し硬化する。これにより、外層ランド部6a、7aの表面及びピアホール9側に露出する端面と、内層導体回路の内層ランド部2a、3aのピアホール9側に露出する端面とが導電性ベースト13によって導電接続することができる。尚、導電性ベースト13の導通抵抗値は、1つのピアホール当たり約100mΩ以下が確保でき、導通状態として充分満足する値である。

【0021】最後に外層ランド部6a、7aの表面に隆起状に露出する導電性ベースト13上にエポキシ樹脂をオーバーコート14a、14bし、導電性ベースト13を保護して多層プリント配線板の製作が完了する。

【0022】このように本発明による多層プリント配線板は、積層板8に貫通したピアホール9内に導電性ベ

ースト13を孔埋め印刷し、この導電性ベースト13を熱硬化させることによって、積層板の外層導体回路と内層導体回路とを電気的に導通接続するようにしたことで、従来技術のようにメッキ被膜により外層導体回路と内層導体回路とを導通接続する構成と異なり、メッキ後の洗浄処理や大がかりな水処理設備が一切不要となり、簡単な製造工程と設備で多層プリント配線板の生産性を向上することができる。従って、低コスト化を図ることができると共に信頼性の高い多層プリント配線板を得ることができる。

【0023】本発明は、上述しきつ図面に示した実施例

に限定されるものでなく、その要旨を逸脱しない範囲内で種々の変形実施が可能である。

【0024】実施例では4層構造の多層プリント配線板について説明したが、3層構造以上の多層プリント配線板に広く適用可能である。

【0025】例えば、図3は6層構造の多層プリント配線板の例であって、両面に導体回路15, 16を有する内層のコア材17と、同じく両面に導体回路18, 19を有する上層コア材20と、さらに両面に導体回路21, 22を有する下層コア材23とをそれぞれプリプレグ24, 25を介して積層板26を構成し、この積層板26に貫通したピアホール27に導電性ベースト28を孔埋め印刷し、導電性ベースト28を熱硬化させることによって、各導体回路15, 16, 18, 19, 21, 22の導体ランド部15a, 16a, 18a, 19a, 21a, 22aを導通接続することができる。

【0026】

【発明の効果】以上説明したように本発明の多層プリント配線板は、絶縁層を介して3層以上の導体層が積層された多層プリント配線板において、積層された各導体層部分に貫通するピアホールを形成し、ピアホールに導電性ベーストを孔埋め印刷し、導電性ベーストを熱硬化させ導体層の外層導体及び内層導体間を電気的に導電接続するようにしたことにより、多層プリント配線板の生産性を向上し大量生産に極めて好適であり、かつ低コスト化を図ることができると共に信頼性の高い多層プリント配線板となる。

【0027】また、導電性ベーストは外層導体では外層表面及びピアホール孔面に露出する端面が導電接続され、内層導体ではピアホール孔面に露出する端面が導電接続されるようにしたことで、孔埋め印刷の際、外層導体面への密着はもとより導体端面に確実に密着し、導電性ベーストの熱硬化によって強固に固着させることができる。

【0028】また、本発明による多層プリント配線板の製造方法は、絶縁性のコア材の両表面にパターン化された導体層を形成し、このコア材の両面にそれぞれプリブ*

* レグを介して外層導体を加熱プレスして積層板を形成する工程と、積層された各導体層部分に対応する位置で積層板に貫通するピアホールを形成する工程と、外層導体をパターン化し、ピアホール周りの外層導体部分のランド部をマスキングしてパターン化された外層導体上にソルダーレジストを形成する工程と、ピアホールに導電性ベーストを孔埋め印刷すると共に、導電性ベーストをランド部にまで印刷する工程と、導電性ベーストを熱硬化する工程と、ランド部上に露出する導電性ベースト面を絶縁性樹脂で印刷し保護する工程とからなるので、従来技術のようにメッキ被膜により外層導体回路と内層導体回路とを導通接続する場合と異なり、メッキ後の洗浄処理や大がかりな水処理設備が一切不要となり、設備も印刷機と乾燥炉のみがあればよいため、設備コストも安価となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】A: 本発明による多層プリント配線板の製造の初期工程図である。
B: 積層板に積層した状態の工程図である。
C: 積層板にピアホールを貫通した工程図である。
D: 外層銅箔のパターン形成とソルダーレジストの形成の工程図である。

【図2】E: ピアホールへの導電性ベーストの孔埋め印刷の工程図である。
F: 導電性ベーストの熱硬化の工程図である。
G: 導電性ベーストへのオーバーコートの工程図である。

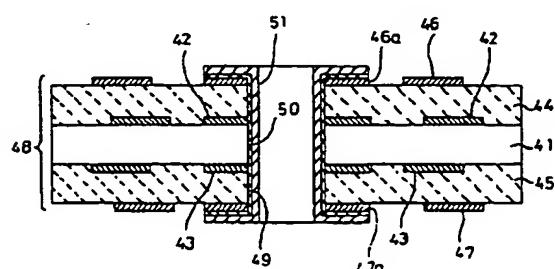
【図3】本発明による6層構造の多層プリント配線板の構成図である。

【図4】従来の多層プリント配線板の構成図である。

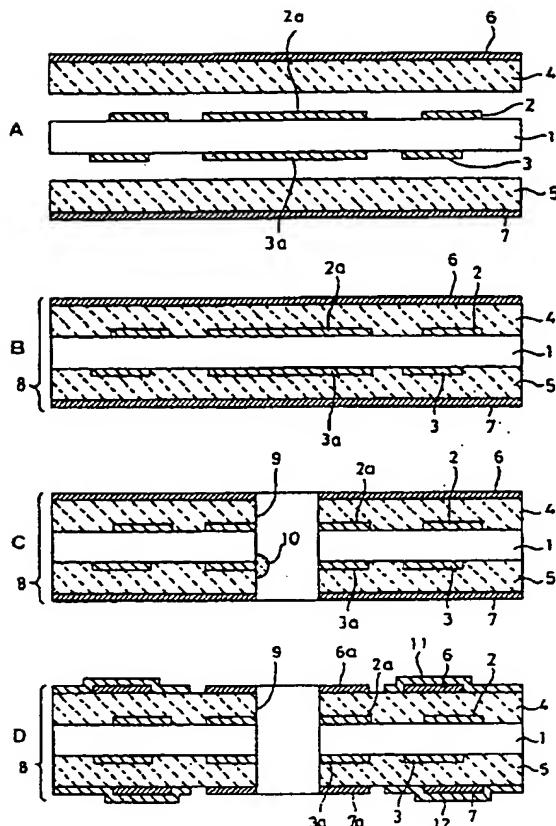
【符号の説明】

1 コア材、2, 3 内層導体回路、2a, 3a 内層ランド部、4, 5 プリプレグ、6, 7 外層導体回路、6a, 7a 外層ランド部、8 積層板、9 ピアホール、11, 12 ソルダーレジスト、13 導電性ベースト、14a, 14b オーバーコート

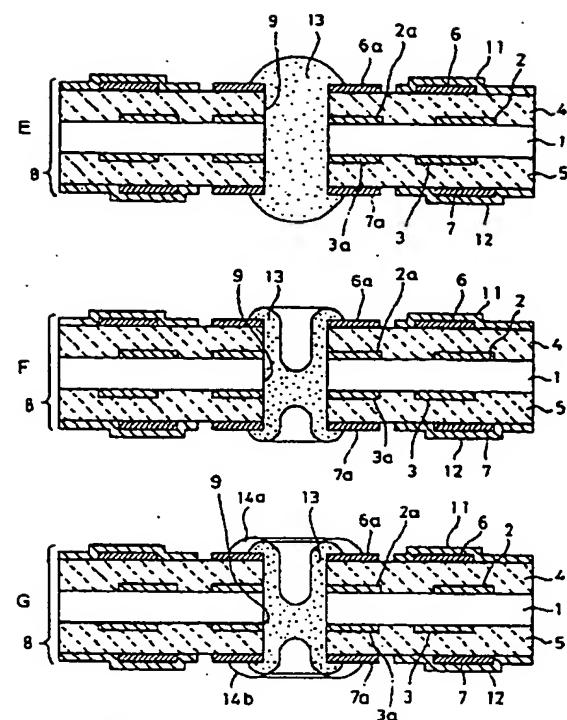
【図4】



(図1)



[図2]



〔図3〕

